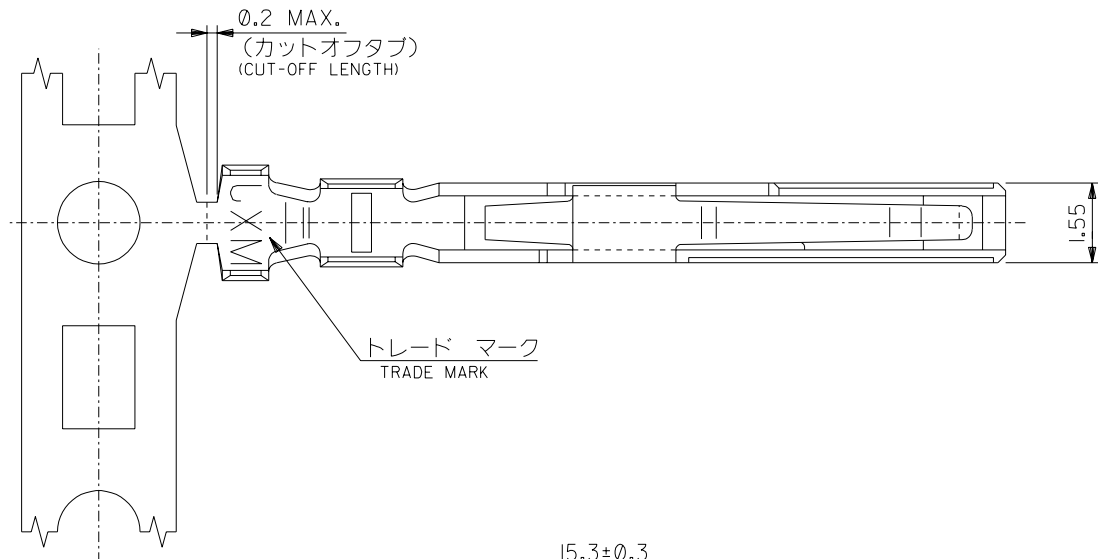
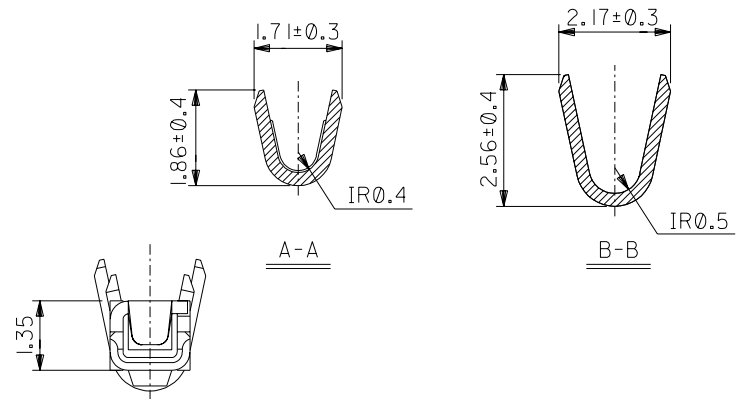
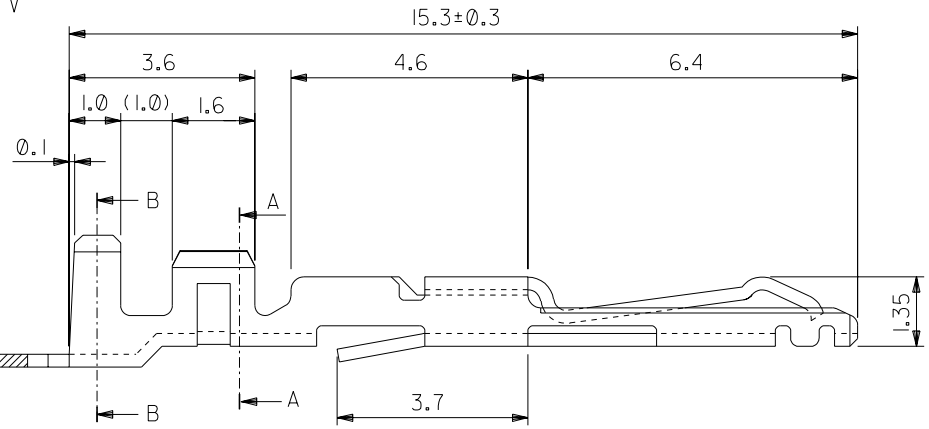


DWG. NO.
SD-50639-001



- 注) NOTES
1. 材質 : りん青銅 t0.25
MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE t0.25
 2. ムッキ仕様
PLATING
接点部 : 金メッキ 0.76μmMIN.
CONTACT AREA : GOLD 0.76μmMIN.
圧着部 : 錫メッキ 1.0μmMIN.
CRIMP AREA : TIN 1.0μmMIN.
下地メッキ : ニッケルメッキ 2μmMIN.
UNDER PLATING : NICKEL 2μmMIN.
 3. 適用圧着ハウジング : 51145-0601/0801
APPLICABLE CRIMP HOUSING : 51145-0601/0801
 4. 適用電線範囲 : AWG #22 - #28
APPLICABLE WIRES : AWG#22 - #28
 5. 被覆外径 : φ1.2mmMAX.
INSULATION O.D : φ1.2 mmMAX.
 6. 適用圧着工具 (手動) : 57353-5000
APPLICABLE CRIMP TOOL (HAND) : 57353-5000
(半自動) : 57353-3000
(ストリッパークリンパー) : 57353-3300
(STRIPPER CRIMPER) : 57353-3300
 7. 適用引抜工具 : 57353-6000
APPLICABLE EXTRACTION TOOL : 57353-6000
 8. 本製品は50639-8*91の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 50639-8*91.



バラ状 / LOOSE	50639-8128
連鎖状 / CHAIN	50639-8028
端子形状 / FORM	MATERIAL NO.

材料 MATERIAL	注参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	注参照 SEE NOTES
適用電線範囲 WIRE RANGE	注参照 SEE NOTES
被覆外径 INS. RANGE	注参照 SEE NOTES
DRAWN BY '04/04/15 H.KAWABATA	CHK'D BY '04/04/15 K.TOJO
APP'D BY '04/04/15 M.SASAO	尺度 SCALE 10 : 1
角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	+0.3
10 以上 30 未満 OVER UNDER	+0.25
10 未満 UNDER	+0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	0
記号 LTR	0
変更内容 REVISION RECORD	新規作成 RELEASED
DR. / CHK.	H.K. / K.T.
日付 DATE	04/04/15

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 2.0 mm PITCH I/O CONN. CRIMP TERMINAL -LEAD FREE-	
DWG. NO.	REV
SD-50639-001	0

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

SD-50639-001.S01